

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

**浙江亨通控股股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二六年八月

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为建设高端铜箔产能、优化产品结构、提升核心竞争力、优化资产负债结构，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《浙江亨通控股股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币360,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	绿能与电子电路用高端铜箔产业园项目	330,151.30	270,000.00
2	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		420,151.30	360,000.00

募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）绿能与电子电路用高端铜箔产业园项目

1、项目基本情况

本项目基本情况如下：

“绿能与电子电路用高端铜箔产业园项目”投资总额为330,151.30万元，拟使用募集资金投入270,000.00万元。项目实施主体为公司子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司，建设地点位于四川省德阳市经济技术开发区八角井街道雪山路。

项目建成后，将新增年产4万吨锂电铜箔、1万吨电子电路铜箔的生产能力，亨通精密铜箔将推动产品体系向更高层次、更高端、更综合的方向全面升级。

2、项目建设的必要性

(1) 契合国家新能源与电子信息战略布局，助力制造强国与能源安全建设

新能源汽车、新型储能、高端电子信息是国家战略性新兴产业的核心支柱，高性能锂电铜箔、高端电子铜箔是保障新能源电池安全高效运行与电子信息产业自主可控的关键基础材料，属于国家战略性新兴产业关键配套产品。国家“十五五”系列规划及新材料、新能源、铜产业专项政策，均鼓励高端电解铜箔、极薄锂电铜箔、高频高速电子铜箔的国产化研发与规模化应用，着力突破国外技术垄断，补齐我国新能源与电子信息产业链供应链短板。

本项目扩产升级的锂电铜箔及电子铜箔，精准适配新能源汽车、储能、5G/AI算力、高端PCB等国家重点工程建设需求，可有效替代进口高端铜箔产品，助力我国新能源电池材料与电子专用材料国产化、自主化升级，保障新能源产业安全与电子信息产业安全，全面契合国家制造强国、数字强国、能源安全新战略要求，具备重要的战略意义。

(2) 填补区域高端铜箔产能缺口，带动西部先进材料产业升级

目前我国常规铜箔产能相对充足，但适配动力电池的极薄锂电铜箔、适配高频高速PCB的高端电子铜箔仍存在一定结构性缺口，西部地区高端铜箔产能尤为紧缺。本项目聚焦高端铜箔产品研发生产，可有效填补四川及西部地区高性能锂电铜箔、高端电子铜箔的产能缺口，推动区域铜箔产业向高端化、智能化、绿色化升级，助力完善我国先进材料产业链供应链体系，带动德阳及周边地区新能源、电子信息产业集聚发展，具备良好的产业带动效应与区域协同价值。

(3) 突破企业产能瓶颈，巩固行业领先地位

作为亨通股份铜箔产业核心基地，亨通铜箔的电解铜箔产品品质、技术水平平均处于国内领先行列，国内外市场订单持续充足。近年来，随着全球新能源汽车、储能、5G建设提速，公司核心产品市场需求持续爆发，现有生产线已高负荷运转，产能缺口持续扩大，无法及时承接下游头部客户的大规模订单，产能不足已成为制约企业规模化发展的核心瓶颈。

本项目实施后，将有效扩充高性能锂电铜箔、高端电子铜箔产能，有效破解现有产能受限难题，大幅提升企业订单承接能力与交付效率。通过规模化生

产进一步降低生产成本、提升产品性价比，持续拓宽国内外市场渠道，扩大全球市场份额，稳固公司在新能源电池材料与电子专用材料领域的行业领先地位，持续强化行业话语权与核心竞争力。

3、项目建设的可行性

（1）市场需求持续高增，行业发展窗口期明确

全球新能源汽车产业持续蓬勃发展，动力电池与储能电池需求长期保持高速增长。同时全球5G/AI算力基础设施、高端消费电子、汽车电子快速迭代，带动高频高速PCB及高端电子铜箔需求持续扩容。下游新能源与电子信息产业处于快速上升周期，市场需求稳定、增长潜力巨大，为项目产能释放、新产品落地推广提供了广阔的市场空间和绝佳的行业窗口期，项目市场前景清晰、风险可控。

（2）区位优势显著，区域产业配套支撑强劲

本项目落地于德阳经济技术开发区，地处成渝地区双城经济圈核心腹地，紧邻成都，区位优势得天独厚，产业配套资源高度集中。德阳经济技术开发区作为国家级经济技术开发区、区域先进制造与新材料产业核心承载区，重点布局新能源、新材料、电子信息等战略性新兴产业，已形成完善的先进材料产业集群与协同发展体系，产业链上下游配套齐全，可为本项目原材料采购、能源供应、产品研发、工程测试提供全方位产业支撑。

同时，德阳作为我国重大技术装备制造业基地，工业基础雄厚，水、电、气等生产要素保障充分，环境承载力较强，具备发展铜箔产业的优越条件。园区持续优化营商环境，在产业政策、科技创新、人才引进、载体建设等方面提供全方位扶持，为项目建设、投产运营、技术迭代提供了优越的区域发展条件。

（3）公司技术积淀深厚，研发创新能力行业领先

亨通铜箔自成立以来，始终深耕高性能电解铜箔领域，坚持技术自主创新，构建了完善的产学研协同创新体系，已具备4.5 μm 至8 μm 铜箔全批量供货能力，掌握3.5 μm 铜箔的生产技术，自主成功开发了高温延伸铜箔（HTE）、低轮廓铜箔（LP）、反转铜箔（RTF）等附加值较高的高端铜箔产品。依托亨通股份雄厚的资金实力与产业链协同优势，亨通铜箔具备持续高强度的研发投入能力，可满足极薄铜箔、高频高速铜箔等高端产品的研发试制与规模化生产，为项目

新产品落地、产能升级提供了坚实的技术保障。

4、项目选址及实施主体

项目实施主体为公司子公司亨通铜箔，建设地点位于德阳市经济技术开发区八角井街道雪山路。

5、项目经济效益

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。

6、项目涉及的报批事项

截至本报告披露日，本项目已取得《四川省固定资产投资项目备案表》，环评等手续尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行环评等手续，相关程序的办理不存在实质性障碍。

（二）补充流动资金

公司拟将本次募集资金中90,000.00万元用于补充流动资金，优化资本结构，提升盈利水平，助力业务快速发展。

随着公司经营战略的实施，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，为未来经营和发展提供充足的资金支持。本次募集资金用于补充流动资金将显著增强公司资金实力，满足公司未来发展的切实资金需求，有利于保障公司未来持续稳定经营。

三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金项目围绕发行人现有主营业务开展，符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及未来公司战略和业务拓展的需要，具有良好的市场前景和盈利空间。有利于提升公司竞争力，进一步提高市场占有率和行业影响力，符合公司战略发展方向。同时，部分募集资金用于补充流动资金将优化公司财务结构，增强资金保障能力与抗风险能力，助力公司业务持续健康发展。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产规模相应增加，资金实力得到进一步提升，为公司的可持续发展提供有力的保障。公司的资产负债率将相应降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。同时，随着募集资金投资项目的推进，项目效益逐步释放，公司整体经营规模、盈利能力将得到一定提升。

四、募集资金使用的可行性分析结论

综上，本次募集资金投资项目，符合国家相关产业政策和行业发展规划，与公司战略规划高度协同，具备必要性与可行性。项目顺利实施后，将有助于公司扩大业务规模、巩固行业领先地位、提升综合竞争力和综合实力，符合公司及全体股东的利益。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年8月13日